

2025 玻璃基板与 TGV 技术大会

随着摩尔定律逼近物理极限，先进封装成为延续半导体性能提升的关键路径。**玻璃基板**凭借其**高密度互连、优异高频特性、低成本面板级工艺**等优势，正在颠覆传统有机基板（ABF/BT）和硅中介层的市场格局。英特尔、三星、台积电等巨头已明确将玻璃基板纳入技术路线图，预计 2030 年全球市场规模突破百亿美元

玻璃通孔技术（TGV）是玻璃基板的核心技术之一，与硅通孔（TSV）相比，具有低成本、大尺寸超薄玻璃衬底易获取、高频电学性能优异等特点。玻璃基板可进行大尺寸生产，具有超薄加工的可能性，基于玻璃通孔（TGV）的转接板工艺在微波系统集成领域中的应用越来越为人们所关注。多年以来，业界及学界许多研究工作都致力于研发低成本、快速可规模化量产的成孔技术。

中国作为全球最大的半导体消费国和封装产业聚集地，亟需在玻璃基板这一战略领域突破技术瓶颈、构建本土供应链。为强化行业信息交流，中粉会展计划于 2025 年 7 月 30 日在无锡举办 **2025 玻璃基板与 TGV 技术大会**。本次论坛将汇聚顶尖专家、产业链领袖及政策制定者，共同探讨技术突破路径与产业化机遇。

会议热诚欢迎行业专家、学者、技术人员、企业界代表出席，同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果，洽谈产、学、研合作。

时间

2025 年 7 月 30 日

（7 月 29 日签到）

地点

无锡锡洲花园酒店

江苏省无锡市锡山区二泉中路 68 号

主办单位



会议主题

- 1、玻璃基板超平整度控制
- 2、超薄化技术与大尺寸生产
- 3、玻璃通孔（TGV）技术工艺流程
- 4、玻璃基板 TGV 工艺的发展前景及进展
- 5、玻璃基板优质金属填充
- 6、玻璃基板紧凑布线设计与接合技术
- 7、先进封装为玻璃基板带来的机遇与挑战

.....

特色活动

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购，工艺方案等需求进行现场采配活动，相关信息将进行展板展示，提高现场沟通交流效率！

征集内容包含但不限于以下几点：

- 1、玻璃基板行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

.....

会议费用

2800 元/人

费用包含：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿

收款账户

户名	山东中粉网信息技术有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行
帐号	37050182640100001790

会务组

联系人：任海鑫

联系方式：18660985530（微信同号）

